

科技部 函

機關地址：台北市和平東路2段106號

聯絡人：沈觀葆

電話：02-2737-7527

傳真：02-2737-7673

電子信箱：gbshen@most.gov.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國106年3月1日

發文字號：科部工字第1060014144號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：積層製造產業應用研究專案計畫構想書-徵求公告 1件，構想書格式 1件（106D2004700.PDF，106D2004701.DOC）

主旨：本部工程司推動106年度「積層製造(數位製造)產業應用研究專案計畫」，自即日起接受申請，詳細徵求公告如附件，請查照。

說明：

- 一、本計畫申請及審查包含「構想書」及「計畫書」兩階段；申請人應於106年4月14日(星期五)中午12時整前，將構想申請書電子檔E-mail至本部工程司聯絡人信箱；構想書獲審查推薦者，請申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提正式計畫申請書(採線上申請)；申請人之任職機構應於106年6月19日(星期一)前函送本部，逾期不予受理。
- 二、本公告未盡事宜，應依本部補助專題研究計畫作業要點、本部補助專題研究計畫經費處理原則及其他相關法令規定辦理。
- 三、本專案相關徵求計畫書說明及詳細內容業已公佈於網站(本部工程司網站<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-最新消息。

正本：專題研究計畫受補助單位（共300單位）

總收文 106/03/01



副本：本部綜合規劃司、工程司(均含附件)

部長陳良基

106/03/01
10:53:07
電子印章

機關影像檔公文

裝

訂

線

